

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2016-08-041

**深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司**  
**关于对深圳证券交易所关注函回复的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2016年8月23日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2016年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-08-040），截止2016年6月30日，以公司总股本495,969,168股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，合计资本公积金转增股本991,938,336股。

2016年8月24日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市兴森快捷电路科技有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第144号）（以下简称“关注函”），深交所对公司披露的上述利润分配及资本公积金转增股本预案表示关注。根据《关注函》的要求，公司对有关事项认真进行了自查，现对相关问题回复如下：

**一、结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，充分说明上述利润分配方案与公司业绩成长性是否相匹配。**

**回复：**

（一）利润分配预案的理由、合理性

## （1）公司所处行业特点

公司以PCB快件样板、中小批量板的设计、销售、制造为依托，向PCB高端制造延伸，形成PCB业务、军品业务和集成电路业务三大业务板块共同发展的局面，各业务所处行业特点、发展阶段及经营模式如下：

**PCB业务特点：**PCB行业已经是一个技术成熟行业且已步入缓慢增长期，从全球PCB市场来看，在经历了之前双位数的增长后，2015年开始减缓至个位数增长，国内PCB产业年增长率预计仍维持在个位数的增长。

**军品业务特点：**2015年以来，军队改革步伐明显加快，建立联合作战指挥体系，实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为海、空装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求。随着国家安全战略升级、国防军费开支的增长为公司在军工市场的持续快速发展提供了市场条件。

**集成电路业务特点：**全球集成电路产业包括先进集成电路封装测试产业快速向中国转移，加上中国本土集成电路封装测试企业的快速发展，使中国IC载板市场需求日趋旺盛。而随着全球IC载板产业逐步向中国转移，加上中国本土IC载板企业的快速发展，以及政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步增加，对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业在我国的发展具有积极的作用，必将推动该行业的快速发展。

## （2）所处发展阶段、未来发展战略

### ① 所处发展阶段

**PCB 业务：**为公司的传统优势业务，为客户提供 PCB 设计——制造（样板、小批量板）——SMT 表面贴装一站式服务，公司是国内规模最大的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业。在未来几年全球 PCB 整体市场不会有大的变化的前提下，随着产品结构的变化，产品迭代加速，传统的单双面板需求将会逐渐减少，FPC 板，HDI 板，刚挠板，高多层板等的市场份额则会增多。而公司的 PCB 样板快件及小批量板，是面向客户的研发需求，将会继续保持持续稳定的增长，公司在 PCB

制造方面，始终保持全球领先的多品种与快速交付能力。

军品业务：公司已深耕军品业务多年，目前应用主要集中在航天、航空领域，为客户提供 CAD 设计+PCB 制造相结合的服务，近两年对军品业务资源的投入以及市场开拓力度的加大驱动公司军工业务实现较快增长，但相较于适合公司服务的军工市场，还有广阔的前景。

集成电路业务：公司集成电路业务主要包括 IC 载板制造在内的 IC 封装解决方案以及半导体测试板整体解决方案。公司 IC 载板业务已建立良好的客户基础，订单争取较为顺利，可以按客户的需求生产各类基板，包括 PBGA、CSP (FBGA)、MCP、PoP、fcCSP、Interposer 等。公司于 2012 年开始布局该业务，第一期设计年产能为 12 万平方米，目前尚处于起步阶段，月产能平均在 3,000~4000 平米之间，初步实现量产能力，达到公司预定的目标。公司全资子公司 Harbor Electronics 具有世界领先技术以及快速交付等集成优势，可以设计制造高层数（最高达 100 层），高板厚（12mm），小间距（0.3mm pitch）、高厚径比（31:1）的半导体测试板，分布在中国、美国、欧洲以及东南亚的设计及服务团队已经为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴。

## ② 未来发展战略

未来，公司将继续围绕三大业务主线积极开展有关工作，在集成电路业务方面，公司在 IC 载板投入巨资，积极为产业链转型升级布局，引进行业世界一流设备和高端技术人才，定位以中高端集成电路封装载板制造为主，随着产品合格率、产量的逐步提升，未来公司将积极打造从载板设计、制造到封测一体化方案解决能力。半导体测试业务具备该细分行业全球领先的方案设计、制造一站式服务能力；未来公司将为北美、亚太地区及国内一流的半导体公司提供服务。随着集成电路产业的快速发展，预计半导体行业的市场空间也将随之扩大，这也是公司在半导体材料、半导体测试行业的进一步布局，同时也将推动公司产业链转型升级，提高公司的综合效益。

公司将充分利用当前军工市场发展的好机遇，利用现有的技术、管理、市场资源等优势，搭建平台，引入新的资源、技术、产品，进一步扩展军工业务。

PCB 业务将通过智能化改造优化提升产能，同时进一步调整订单结构，拓展新产品、改进工艺技术、导入高附加值订单。公司将通过以上措施提升 PCB 业务产能和效率、保

持并提升毛利率。此外，公司也将进一步完善海外市场的布局，提升公司在海外主要市场的占有率，确保公司整体销售收入的持续增长。

### （3）主要经营模式

PCB业务采用CAD设计、销售、制造（样板、小批量板）、SMT表面贴装一站式服务的经营模式。

军品业务采用硬件研发、生产、销售一站式服务的经营模式。

#### 集成电路业务

IC载板采用IC载板的生产、销售的经营模式。

半导体测试板采用设计、销售、制造、表面贴装整体解决方案一站式服务的经营模式。

### （二）利润分配预案与公司业绩的匹配性

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年6月30日，公司资本公积金为999,907,792.36元。目前，公司经营情况良好，主营业务发展迅速，盈利水平稳步增长。2016年1-6月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,718,000.81元，较上年同期增长39.18%。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生提出上述利润分配预案。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。

**二、上述利润分配方案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。**

**回复：**

2016年8月10日，公司股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏向公司董事长邱醒亚先生提出了公司2016年半年度利润分配预案的提议，当日，董事长邱醒亚先生，召集董事会秘书陈岚女士，会同提案人柳敏先生一起进行了商讨，经讨论决定，将此提案提交公司半年度董事会会议审议，8月11日，公司董事会秘书陈岚女士以邮件形式向全体董事发出召开第四届董事会第十四次会议的会议通知，邮件同时抄送全体监事、高级管理人员，会议审议议案包含《关于公司2016年半年度利润分配预案》。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表。

本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现董事、监事、高级管理人员、众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计签字老师等相关人员及其直系亲属有买卖公司股票的情况。

### **三、你公司认为应当说明或披露的其他事项。**

#### **回复：**

公司不存在其他应当说明或披露的事项。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日